

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 5月 8日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-174440

出 願 人

Applicant(s):

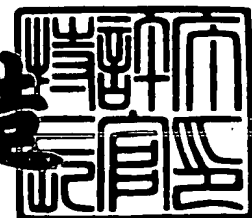
東京エレクトロン株式会社



2001年 3月16日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3021111

【書類名】 特許願

【整理番号】 JPP000051

【提出日】 平成12年 5月 8日

【あて先】 特許庁長官 近藤 隆彦殿

【国際特許分類】 C25D 5/00

【発明の名称】 メッキ処理装置及びメッキ処理方法

【請求項の数】 13

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県津久井郡城山町町屋1丁目2番41号 東京エレクトロン イー・イー株式会社 内

【氏名】 大加瀬 亘

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650 東京エレクトロン株式会社 内

【氏名】 朴 慶浩

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県津久井郡城山町町屋1丁目2番41号 東京エレクトロン イー・イー株式会社 内

【氏名】 松尾 剛伸

【特許出願人】

【識別番号】 000219967

【氏名又は名称】 東京エレクトロン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100077849

【弁理士】

【氏名又は名称】 須山 佐一

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014395

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9104549

【書類名】 明細書

【発明の名称】 メッキ処理装置及びメッキ処理方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 処理液を収容する処理液槽と、
前記被処理基板の中心に穿孔された貫通孔を介して前記被処理基板の裏面側から接触して電圧を印加する電圧印加手段と、
を具備するメッキ処理装置。

【請求項 2】 処理液を収容する処理液槽と、
前記被処理基板の中心に表面側から接触して電圧を印加する電圧印加手段と、
を具備するメッキ処理装置。

【請求項 3】 処理液を収容する処理液槽と、
前記被処理基板の中心に穿孔された貫通孔を介して前記被処理基板の裏面側から接触して電圧を印加する第 1 の電圧印加手段と、
前記被処理基板の外周縁で前記被処理基板に接触して電圧を印加する第 2 の電圧印加手段と、
を具備するメッキ処理装置。

【請求項 4】 請求項 3 に記載のメッキ処理装置であって、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で所定時間毎に印加電圧の強弱が交互に変化するように制御する印加電圧制御手段を更に具備することを特徴とするメッキ処理装置。

【請求項 5】 請求項 3 に記載のメッキ処理装置であって、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で片方ずつ電圧を印加するように制御する印加電圧制御手段を更に具備することを特徴とするメッキ処理装置。

【請求項 6】 請求項 3 に記載のメッキ処理装置であって、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で印加電圧を所定の割合で同時に印加するように制御する印加電圧制御手段を更に具備することを特徴とするメッキ処理装置。

【請求項 7】 処理液を収容する処理液槽と、
水平に保持した被処理基板を昇降して前記被処理基板内周側の被処理部を前記

処理液に接離するホルダと、

前記被処理基板の中心に表面側から接触して電圧を印加する第 1 の電圧印加手段と、

前記被処理基板の外周縁で前記被処理基板に接触して電圧を印加する第 2 の電圧印加手段と、

を具備するメッキ処理装置。

【請求項 8】 請求項 7 に記載のメッキ処理装置であって、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で所定時間毎に印加電圧の強弱が交互に変化するように制御する印加電圧制御手段を更に具備することを特徴とするメッキ処理装置。

【請求項 9】 請求項 7 に記載のメッキ処理装置であって、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で片方ずつ電圧を印加するように制御する印加電圧制御手段を更に具備することを特徴とするメッキ処理装置。

【請求項 10】 請求項 7 に記載のメッキ処理装置であって、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で印加電圧を所定の割合で同時に印加するように制御する印加電圧制御手段を更に具備することを特徴とするメッキ処理装置。

【請求項 11】 液処理槽内に收容した処理液を介して対向配置された被処理基板及びアノードに電圧を印加することにより前記被処理基板にメッキ処理を施すメッキ処理方法であって、前記被処理基板の中心に電圧を印加することを特徴とするメッキ処理方法。

【請求項 12】 液処理槽内に收容した処理液を介して対向配置された被処理基板及びアノードに電圧を印加することにより前記被処理基板にメッキ処理を施すメッキ処理方法であって、前記被処理基板の中心と外周縁との間で所定時間毎に交互に印可電圧の強弱を変化させることを特徴とするメッキ処理方法。

【請求項 13】 液処理槽内に收容した処理液を介して対向配置された被処理基板及びアノードに電圧を印加することにより前記被処理基板に液処理を施すメッキ処理方法であって、前記被処理基板の中心と外周縁との間で片方ずつ電圧を印加することを特徴とするメッキ処理方法。

【請求項 1 4】 液処理槽内に收容した処理液を介して対向配置された被処理基板及びアノードに電圧を印加することにより前記被処理基板に液処理を施すメッキ処理方法であって、前記被処理基板の中心と外周縁との間で印加電圧を所定の割合で同時に印加することを特徴とするメッキ処理方法。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

本発明はウエハ等の被処理基板上にメッキ層を形成するメッキ処理技術に係り、更に詳細には処理液に浸漬した被処理基板に電圧を印加しながらメッキ処理を行なう電解型のメッキ処理装置及びメッキ処理方法に関する。

【従来の技術】

従来より、シリコンウエハなどの被処理基板上に銅層などのメッキ層を形成するメッキ処理装置として、底部にアノード電極を配設したメッキ液槽内にメッキ液を満たしておき、このメッキ液液面に対して被処理基板を下向きにして浸漬し、この状態でウエハWとアノードとの間に電圧を印加するフェイスダウン方式の装置が知られている。

図 1 7 は典型的なフェイスダウン型のメッキ処理装置の垂直断面図である。例えば、図 1 7 に示したメッキ処理装置では、メッキ液を上部が開口した処理液槽 2 0 2 に收容し、このメッキ液に対して被処理基板Wの被処理面を下向きに水平に保持し、この状態で被処理基板Wをメッキ液に浸漬し、アノードとウエハWとの間に所定の電圧を印加して被処理面上にメッキ層を形成する。この方法では、処理装置を小型化できるという利点があり、広く用いられつつある。

この図 1 7 に示したようなメッキ処理装置では、ウエハWの外周縁にカソードコンタクトと呼ばれる電氣的接点を接触させ、このカソードコンタクトを介してウエハW下面側の被処理面に電圧を印加し、ウエハW下面側をカソードとして機能させる。

ところで、ウエハWから製品として形成される半導体素子の歩留まりを向上させる関係上、ウエハW下面側の被処理面に形成するメッキ層の厚さはウエハWの被処理面全体にわたって均一であることが求められる。

【発明が解決しようとする課題】

しかし、図 1 7 に示したようにウエハ W 下面側の外周縁で接触するカソードコンタクトを介してウエハ W の被処理面に電圧を印加する構造では、カソードコンタクトに近い外周縁側で印加電圧が高く、カソードコンタクトから離れたウエハ W の中心付近では印加電圧が低くなる傾向があるため、ウエハ W の中心付近ではメッキ層が薄く、ウエハ W の外周縁付近に近づくほどメッキ層が厚く形成されやすいため、ウエハ W の面内でメッキ層の厚さが不均一になり、半導体素子の歩留まりが低下したり、半導体素子の品質にばらつきが生じ易いという問題がある。

本発明は上記従来の問題を解決するためになされたものである。即ち、本発明は、ウエハ W の面内で厚さが均一なメッキ層を形成することのできるメッキ処理装置及びメッキ処理方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

請求項 1 のメッキ処理装置は、処理液を収容する処理液槽と、水平に保持した被処理基板を昇降して前記被処理基板内周側の被処理部を前記処理液に接離するホルダと、前記被処理基板の中心に穿孔された貫通孔を介して前記被処理基板の裏面側から接触して電圧を印加する電圧印加手段と、を具備する。

請求項 1 のメッキ処理装置では、前記被処理基板の中心に穿孔された貫通孔を介して前記被処理基板の裏面側から接触して電圧を印加する電圧印加手段を備えており、被処理基板全体にわたって均一に電圧を印加することができるので、被処理基板全体に均一な処理を施すことが出来る。

請求項 2 のメッキ処理装置は、処理液を収容する処理液槽と、水平に保持した被処理基板を昇降して前記被処理基板内周側の被処理部を前記処理液に接離するホルダと、前記被処理基板の中心に表面側から接触して電圧を印加する電圧印加手段と、を具備する。

請求項 2 のメッキ処理装置では、前記被処理基板の中心に表面側から接触して電圧を印加する電圧印加手段を備えており、被処理基板全体にわたって均一に電圧を印加することができるので、被処理基板全体に均一な処理を施すことが出来る。

請求項 3 のメッキ処理装置は、処理液を収容する処理液槽と、水平に保持した被処理基板を昇降して前記被処理基板内周側の被処理部を前記処理液に接離する

ホルダと、前記被処理基板の中心に穿孔された貫通孔を介して前記被処理基板の裏面側から接触して電圧を印加する第 1 の電圧印加手段と、前記被処理基板の外周縁で前記被処理基板の表面側に接触して電圧を印加する第 2 の電圧印加手段と、を具備する。

請求項 3 のメッキ処理装置では、前記被処理基板の中心に穿孔された貫通孔を介して前記被処理基板の裏面側から接触して電圧を印加する第 1 の電圧印加手段を備えており、被処理基板全体にわたって均一に電圧を印加することができるので、被処理基板全体に均一な処理を施すことが出来る。

請求項 4 のメッキ処理装置は、請求項 3 に記載のメッキ処理装置において、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で所定時間毎に印加電圧の強弱が交互に変化するように制御する印加電圧制御手段を更に具備する。

請求項 4 のメッキ処理装置では、請求項 3 に記載のメッキ処理装置において、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で所定時間毎に印加電圧の強弱が交互に変化するように制御する印加電圧制御手段を更に具備しており、被処理基板全体にわたって均一に電圧を印加することができるので、被処理基板全体に均一な処理を施すことが出来る。

請求項 5 のメッキ処理装置は、請求項 3 に記載のメッキ処理装置において、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で片方ずつ電圧を印加するように制御する印加電圧制御手段を更に具備する。

請求項 5 のメッキ処理装置では、請求項 3 に記載のメッキ処理装置において、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で片方ずつ電圧を印加するように制御する印加電圧制御手段を更に具備しており、被処理基板全体にわたって均一に電圧を印加することができるので、被処理基板全体に均一な処理を施すことが出来る。

請求項 6 のメッキ処理装置は、請求項 3 に記載のメッキ処理装置において、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で印加電圧を所定の割合で同時に印加するように制御する印加電圧制御手段を更に具備する。

請求項 6 のメッキ処理装置では、請求項 3 に記載のメッキ処理装置において、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で印加電圧を所定の

割合で同時に印加するように制御する印加電圧制御手段を更に具備しており、被処理基板全体にわたって均一に電圧を印加することができるので、被処理基板全体に均一な処理を施すことが出来る。

請求項 7 のメッキ処理装置は、処理液を収容する処理液槽と、水平に保持した被処理基板を昇降して前記被処理基板内周側の被処理部を前記処理液に接離するホルダと、前記被処理基板の中心に表面側から接触して電圧を印加する第 1 の電圧印加手段と、前記被処理基板の外周縁で前記被処理基板の表面側に接触して電圧を印加する第 2 の電圧印加手段と、を具備する。

請求項 7 のメッキ処理装置では、前記被処理基板の中心に表面側から接触して電圧を印加する第 1 の電圧印加手段を備えており、被処理基板全体にわたって均一に電圧を印加することができるので、被処理基板全体に均一な処理を施すことが出来る。

請求項 8 のメッキ処理装置は、請求項 7 に記載のメッキ処理装置において、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で所定時間毎に印加電圧の強弱が交互に変化するように制御する印加電圧制御手段を更に具備する。

請求項 8 のメッキ処理装置では、請求項 7 に記載のメッキ処理装置において、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で所定時間毎に印加電圧の強弱が交互に変化するように制御する印加電圧制御手段を更に具備しており、被処理基板全体にわたって均一に電圧を印加することができるので、被処理基板全体に均一な処理を施すことが出来る。

請求項 9 のメッキ処理装置は、請求項 7 に記載のメッキ処理装置において、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で片方ずつ電圧を印加するように制御する印加電圧制御手段を更に具備する。

請求項 9 のメッキ処理装置では、請求項 7 に記載のメッキ処理装置において、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で片方ずつ電圧を印加するように制御する印加電圧制御手段を更に具備しており、被処理基板全体にわたって均一に電圧を印加することができるので、被処理基板全体に均一な処理を施すことが出来る。

請求項 10 のメッキ処理装置は、請求項 7 に記載のメッキ処理装置において、

前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で印加電圧を所定の割合で同時に印加するように制御する印加電圧制御手段を更に具備する。

請求項 1 0 のメッキ処理装置では、請求項 7 に記載のメッキ処理装置において、前記第 1 の電圧印加手段と、前記第 2 の電圧印加手段との間で印加電圧を所定の割合で同時に印加するように制御する印加電圧制御手段を更に具備しており、被処理基板全体にわたって均一に電圧を印加することができるので、被処理基板全体に均一な処理を施すことが出来る。

請求項 1 1 のメッキ処理方法は、液処理槽内に収容した処理液を介して対向配置された被処理基板及びアノードに電圧を印加することにより前記被処理基板にメッキ処理を施すメッキ処理方法であって、前記被処理基板の中心に電圧を印加することを特徴とする。

請求項 1 1 のメッキ処理方法では、液処理槽内に収容した処理液を介して対向配置された被処理基板及びアノードに電圧を印加することにより前記被処理基板に液処理を施すメッキ処理方法において、前記被処理基板の中心に電圧を印加しており、被処理基板全体にわたって均一に電圧を印加することができるので、被処理基板全体に均一な処理を施すことが出来る。

請求項 1 2 のメッキ処理方法は、液処理槽内に収容した処理液を介して対向配置された被処理基板及びアノードに電圧を印加することにより前記被処理基板に液処理を施すメッキ処理方法であって、前記被処理基板の中心と外周縁との間で所定時間毎に交互に印可電圧の強弱を変化させることを特徴とする。

請求項 1 2 のメッキ処理方法では、液処理槽内に収容した処理液を介して対向配置された被処理基板及びアノードに電圧を印加することにより前記被処理基板に液処理を施すメッキ処理方法において、前記被処理基板の中心と外周縁との間で所定時間毎に交互に印可電圧の強弱を変化させており、被処理基板全体にわたって均一に電圧を印加することができるので、被処理基板全体に均一な処理を施すことが出来る。

請求項 1 3 のメッキ処理方法は、液処理槽内に収容した処理液を介して対向配置された被処理基板及びアノードに電圧を印加することにより前記被処理基板に液処理を施すメッキ処理方法であって、前記被処理基板の中心と外周縁との間で

片方ずつ電圧を印加することを特徴とする。

請求項 1 3 のメッキ処理方法では、液処理槽内に収容した処理液を介して対向配置された被処理基板及びアノードに電圧を印加することにより前記被処理基板に液処理を施すメッキ処理方法において、前記被処理基板の中心と外周縁との間で片方ずつ電圧を印加しており、被処理基板全体にわたって均一に電圧を印加することができるので、被処理基板全体に均一な処理を施すことが出来る。

請求項 1 4 のメッキ処理方法は、液処理槽内に収容した処理液を介して対向配置された被処理基板及びアノードに電圧を印加することにより前記被処理基板に液処理を施すメッキ処理方法であって、前記被処理基板の中心と外周縁との間で印加電圧を所定の割合で同時に印加することを特徴とする。

請求項 1 4 のメッキ処理方法では、液処理槽内に収容した処理液を介して対向配置された被処理基板及びアノードに電圧を印加することにより前記被処理基板に液処理を施すメッキ処理方法において、前記被処理基板の中心と外周縁との間で印加電圧を所定の割合で同時に印加しており、被処理基板全体にわたって均一に電圧を印加することができるので、被処理基板全体に均一な処理を施すことが出来る。

【課題を解決するための手段】

(第 1 の実施の形態)

以下、本発明の第一の実施の形態に係る銅メッキ用のメッキ処理システムについて説明する。

図 1 は本実施形態に係るメッキ処理システムの斜視図であり、図 2 は同メッキ処理システムの平面図であり、図 3 は同メッキ処理システムの正面図であり、図 4 は同メッキ処理システムの側面図である。

図 1 ～図 4 に示したように、このメッキ処理システム 1 はウエハ W を出し入れたり運搬するキャリアステーション 2 とウエハ W に実際に処理を施すプロセスステーション 3 とから構成されている。

キャリアステーション 2 はウエハ W を収容する載置台 2 1 と載置台 2 1 上に載置されたキャリアカセット C にアクセスしてその中に収容されたウエハ W を取り出したり、処理が完了したウエハ W を収容したりする第 2 の搬送手段としてのサ

ブアーム 2 2 とから構成されている。

キャリアカセット C 内には複数枚、例えば 2 5 枚のウエハ W を等間隔毎に水平に保った状態で垂直方向に収容されるようになっている。載置台 2 1 上には図中 X 方向に例えば 4 個のキャリアカセット C が配設されている。

サブアーム 2 2 は図中 X 方向に配設されたレール上を移動するとともに鉛直方向（Z 方向）即ち図中紙面に垂直な方向に昇降可能かつ水平面内で回転可能な構造を備えており、載置台 2 1 上に載置されたキャリアカセット C 内にアクセスして未処理のウエハ W をキャリアカセット C から取り出したり、処理が完了したウエハ W をキャリアカセット C 内に収納するようになっている。

またこのサブアーム 2 2 は後述するプロセスステーション 3 との間でも、処理前後のウエハ W を受け渡しするようになっている。

プロセスステーション 3 は図 1 ～図 4 に示すように直方体又は立方体の箱型の外観を備えており、その周囲全体は耐腐食性の材料、例えば樹脂や表面を樹脂でコーティングした金属板などでできたハウジング 3 1 で覆われている。

プロセスステーション 3 の内部は図 1 及び図 4 に示すように略立方形或いは直方形の箱型の構成となっており、内部には処理空間 S が形成されている。

処理空間 S は図 1 及び図 4 に示したように直方体型の処理室であり、処理空間 S の底部には底板 3 3 が取り付けられている。

処理空間 S には、複数の処理ユニット、例えば 4 基のメッキ処理ユニット M 1 ～M 4 が例えば処理空間室 S 内の、次に説明するメインアーム 3 5 の周囲にそれぞれ配設されている。

図 1 及び図 2 に示すように底板 3 3 のほぼ中央にはウエハを搬送するための第 1 の搬送手段としてのメインアーム 3 5 が配設されている。このメインアーム 3 5 は昇降可能かつ水平面内で回転可能になっており、更に略水平面内で伸縮可能な上下二本のウエハ保持部材を備えており、これらのウエハ保持部材を伸縮させることによりメインアーム 3 5 の周囲に配設された処理ユニットに対して処理前後のウエハ W 出し入れできるようになっている。またメインアーム 3 5 は垂直方向に移動して上側の処理ユニットへも出入りできるようになっており、下段側の処理ユニットから上段側の処理ユニットへウエハ W を運んだり、その逆に上側の

処理ユニットから下段側の処理ユニットへウエハWを運ぶこともできるようになっている。

更にこのメインアーム35は保持したウエハWを上下反転させる機能を備えており、一の処理ユニットから他の処理ユニットへウエハWを搬送する間にウエハWを上下反転できる構造を備えている。なおこのウエハWを反転できる機能はメインアーム35に必須の機能ではない。

上段側には他の処理ユニット、例えば第2のメッキ処理装置としての洗浄処理ユニットSRDが例えば2基キャリアステーションに近い側、即ち前記メッキ処理ユニットM1、M2の上側にそれぞれ配設されている。

このように複数の処理ユニットが上下方向に多段配置されているので、液処理システムの面積効率を向上させることが出来る。

プロセスステーション3のハウジング31のうち、キャリアステーション2に対面する位置に配設されたハウジング31aには、図3に示すように3つの開閉可能な開口部G1～G3が配設されている。これらのうちG1は下段側に配設されたメッキ処理ユニットM1とM2との間に配設された中継載置台36の位置に対応する開口部であり、キャリアカセットCからサブアーム22が取り出した未処理のウエハWをプロセスステーション3内に搬入する際に用いられる。搬入の際には開口部G1が開かれ、未処理ウエハWを保持したサブアーム22が処理空間S内にウエハ保持部材を伸ばしてアクセスし、中継載置台36上にウエハWを置く。この中継載置台36にメインアーム35がアクセスし、中継載置台36上に載置されたウエハWを保持してメッキ処理ユニットM1～M4などの処理ユニット内まで運ぶ。

残りの開口部G2及びG3は処理空間Sのキャリアステーション2に近い側に配設されたSRDに対応する位置に配設されており、これらの開口部G2、G3を介してサブアームが処理空間S内にアクセスし、上段側に配設されたSRDに直接アクセスして処理が完了したウエハWを受け取ることができるようになっている。

そのためSRDで洗浄されたウエハWが汚れたメインアームに触れて汚染されることが防止される。

また、処理空間 S 内には図 4 中上から下向きのエアフローが形成されており、システム外から供給された清浄なエアが処理空間 S の上部から供給され、洗浄処理ユニット、メッキ処理ユニット M 1 ～ M 4 に向けて流下し、処理空間 S の底部から排気されてシステム外に排出されるようになっている。

このように処理空間 S 内を上から下に清浄な空気を流すことにより、下段側のメッキ処理ユニット M 1 ～ M 4 から上段側の洗浄装置の方には空気が流れないようになっている。そのため、常に洗浄処理ユニット側は清浄な雰囲気には保たれている。

更に、メッキ処理ユニット M 1 ～ M 4 や洗浄処理ユニット等の各処理ユニット内はシステムの処理空間 S よりも陰圧に維持されており、空気の流れは処理空間 S 側から各処理ユニット内に向かって流れ、各処理ユニットからシステム外に排気される。そのため、処理ユニット側から処理空間 S 側に汚れが拡散するのが防止される。

図 5 はメッキ処理ユニット M 1 の垂直断面図である。図 5 に示すように、このメッキ処理ユニット M 1 では、ユニット全体が密閉構造のハウジング 4 1 で覆われている。このハウジング 4 1 も樹脂等の耐腐食性の材料で構成されている。

ハウジング 4 1 の内側は概ね上下二段に分かれた構造になっており、排気路を内蔵したセパレータ 7 2 により、セパレータ 7 2 の上側に位置する第 1 の処理部 A と、セパレータ 7 2 の下側に位置する第 2 の処理部 B とに仕切り分けられている。

そのため、第 2 の処理部 B 側から上側の第 1 の処理部 A 側に汚れが拡散するのが防止される。

セパレータ 7 2 の中央には貫通孔 7 4 が設けられており、この貫通孔 7 4 を介して後述するドライバ 6 1 に保持されたウエハ W が第 1 の処理部 A と第 2 の処理部 B との間を行き来できるようになっている。

処理部 A と処理部 B との境界にあたる部分のハウジングには開口部とこの開口部を開閉するゲートバルブ 7 3 が設けられている。このゲートバルブ 7 3 を閉じるとメッキ処理ユニット M 1 内はその外側の処理空間 S とは隔絶された空間となるので、メッキ処理ユニット M 1 から外側の処理空間 S 内への汚れの拡散が防止

される。

またメッキ処理ユニットM1～M4はそれぞれ別個独立に運転することができ、処理システムに対してそれぞれが着脱可能に構成されている。そのため、一つのメッキ処理ユニットについての保守管理時など運転できない場合には、他のメッキ処理ユニットを代替使用することができ、保守管理が容易に行なえる。

第1の処理部AにはウエハWを略水平に保持して回転させる基板保持機構としてのドライバ61が配設されている。このドライバ61はウエハWを保持するホルダ62と、このホルダ62ごとウエハWを略水平面内で回転させるモータ63とから構成されており、モータ63の外殻容器にはドライバ61を支持する支持梁67が取り付けられている。支持梁67の端はハウジング41の内壁に対してガイドレール68を介して昇降可能に取り付けられている。支持梁67は更にシリンダ69を介してハウジング41に取り付けられており、このシリンダ69を駆動することによりドライバ61の位置を上下できるようになっている。

具体的には図5に示したように、ドライバ61の位置はウエハWを搬出入するための搬送位置(I)と、ウエハW下面側の被処理面を洗浄する洗浄位置(II)後述するスピンドライを行なうためのスピンドライ位置(IV)、及びウエハWをメッキ液に浸漬した状態でメッキを行なうメッキ位置(V)の主に4つの異なる高さの間で上下動させる。

ドライバ61の内部にはウエハWだけを昇降させる昇降機構(図示省略)が配設されており、この昇降機構を作動させることにより、ドライバ61の高さを変えずにウエハWの高さだけをドライバ61内部で変えることができる。

この昇降機構はウエハW下面外周縁部で接触して電圧を印加するカソードコンタクト64とウエハWとを接離させるときに作動させるものであり、例えばカソードコンタクト64を洗浄する際にウエハWを上昇させて接点表面を露出させ、ノズルから噴射された水により洗浄しやすくする。

第2の処理部Bには例えば硫酸銅などの、銅メッキ用のメッキ液を収容するメッキバス42が配設されている。

メッキバス42は二重構造になっており、内槽42aの外側に外槽42bが略同軸的に配設されている。メッキバス42は前述したドライバ61の真下に配設

されており、メッキ液で内槽 4 2 a を満たしたときにメッキ液の液面がメッキ位置 (V) で停止させたドライバ 6 1 に保持されたウエハ W よりもメッキ液液面の方が高くなる高さに内槽 4 2 a が固定されている。

内槽 4 2 a の内部にはメッキ液を底部側から上面に向けて噴出させる噴出管 4 3 が内槽 4 2 a の底部略中心から内槽 4 2 a の深さ方向略中間付近まで伸びており、噴出管 4 3 の周囲には電解メッキ処理時にアノードとして機能する電極 4 4 が配設されている。噴出管 4 3 の端部外周と内槽 4 2 a との間には隔膜 4 5 が配設されており、電解メッキ時に電極 4 4 から混入する異物がメッキ液液面に浮上してメッキの障害になるのを防止している。内槽 4 2 a 底部の中心から偏心した位置にはメッキ液を循環させるための循環配管 4 6, 4 7 が配設されており、図示しないポンプによりメッキ液を循環させ、循環配管 4 7 で吸い込んだメッキ液を循環配管 4 6 から供給するようになっている。

外槽 4 2 b は内槽 4 2 a の外壁面との間にメッキ液の流れる流路 4 2 c を形成している。更に外槽 4 2 b の底部には流路 4 2 c に流れ込んだメッキ液を内槽 4 2 a 内に戻すための配管 4 8 が接続されている。この配管 4 8 は前記噴出管 4 3 とポンプ 4 9 を介して繋がっており、このポンプ 4 9 を作動させることにより内槽 4 2 a から溢れ出して流路 4 2 c、配管 4 8 に流れ込んだメッキ液を再び内槽 4 2 a 内に戻すと共にウエハ W 下面側の被処理面に向けて噴出できるようになっている。

次に本実施形態に係るホルダ 6 2 下端部のウエハ W 保持部分について説明する。

図 6 は本実施形態に係るメッキ処理ユニットのホルダ 6 2 周辺の垂直断面を部分的に拡大した図である。

図 6 に示したように、本実施形態に係るメッキ処理ユニットでは、被処理基板として中心に貫通孔 h が穿孔されたウエハ W を用いる。この貫通孔 h を介してウエハ W の裏面、即ちメッキ層を形成しない図中上面側から電圧印加手段としてのセンターカソード 9 0 で電圧を印加する。

このセンターカソード 9 0 は、例えば、シード層 C が裏面側まで形成されたウエハ W の貫通孔 h にその裏面側から直接接触するセンターカソードコンタクト 9

1 と、このセンターカソードコンタクト 9 1 を付勢するコイルスプリング 9 2 と、このコイルスプリング 9 2 の下部を支持する円筒型のハウジング 9 3 と、このハウジング 9 3 の開口部側に取り付けられ、前記センターカソードコンタクト 9 1 とウエハ W との接点周辺をシールする、例えばシリコンゴムなどの可撓性絶縁材料でできた、お椀型シーラント 9 4 とから構成されており、センターカソードコンタクト 9 1 には電気を供給するためのリード線 9 5 が取り付けられている。

このリード線 9 5 は後述するようにカソードコンタクト 6 4 と同電位の電圧が印加されるように電源に接続されている。

なお、シーラント 9 4 の内部空間には空気や不活性ガスなどを供給して正圧をかけられるようにしておき、センターカソードコンタクト 9 1 とウエハ W との接点にメッキ液が付着するのを防止することもできる。

図 7 は本実施形態に係るメッキ処理ユニットのカソード電圧を印加する電気系統を示す配線図である。

図 7 に示すように、このメッキ処理ユニットでは、カソードコンタクト 6 4, 6 4, …と同じ極性の電圧がセンターカソードコンタクト 9 1 に印加されるようになっており、更にスイッチ S を切りかえることにより、カソードコンタクト 6 4, 6 4, …とセンターカソードコンタクト 9 1 との間で交互に電圧を印加したり、同時に電圧を印加したり、片方ずつ電圧を印加することができるようになっている。

更にこのスイッチ S を適切なコントローラに置きかえることにより、印加電圧の強さを徐々に変化させることもできる。

次に本実施形態に係るメッキ処理システム全体の処理プロセスについて説明する。

図 8 はメッキ処理システム全体のフローを示すフローチャートである。

図 8 に示すように、電源を投入してこのメッキ処理システムを立ち上げ、載置台 2 1 上に未処理のウエハ W が 1 ロット、例えば 2 5 枚収容されたキャリアカセット C を図示しない搬送用ロボットを使って載置すると、サブアーム 2 2 は未処理ウエハ W がセットされたことを認識してキャリアカセット C の前まで移動し、

ウエハ保持部 2 2 a をキャリアカセット C 内に差し込んで中に収容されている未処理のウエハ W を取り出し、このウエハ W をプロセスステーション内にある中継載置台 3 6 上に一旦載置する。なお、載置台 2 1 の近傍にアライメント調整装置（図示省略）を配設し、このアライメント調整装置でウエハ W の向き（アライメント）を調整してからサブアーム 2 2 や中継載置台 3 6 上にウエハ W が搬送されるようにしてもよい。

中継載置台 3 6 上に未処理ウエハ W が載置されると、メインアーム 3 5 がウエハ W の載置を認識して作動を開始し、中継載置台 3 6 のところまでアクセスして未処理ウエハ W を受け取る。未処理ウエハ W を受け取ったメインアーム 3 5 は今度は処理空間 S の下段側に配設されたメッキ処理ユニット、例えばメッキ処理ユニット M 1 にアクセスしてこのメッキ処理ユニット M 1 内へ未処理のウエハ W を搬入する。

以下、メッキ処理ユニット M 1 内での処理のフローについては図 1 0 に沿って説明する。

図 9 はメッキ処理ユニット M 1 内で行なわれるメッキ処理のフローを図示したフローチャートである。

中継載置台 3 6 から未処理のウエハ W を受け取ったメインアーム 3 5 はメッキ処理ユニット M 1 にアクセスする。即ち、メッキ処理ユニット M 1 ではゲートバルブ 7 3 が開かれ、未処理ウエハ W を保持したままメインアーム 3 5 が第 1 の処理部 A に進入して前記搬送位置（I）で待機しているドライバ 6 1 のホルダ 6 2 に未処理のウエハ W を引き渡す（ステップ 2（1））。

未処理のウエハ W をドライバ 6 1 のホルダ 6 2 にセットし終えたら、ゲートバルブ 7 3 を閉じ、シリンダ 6 9 を駆動してドライバ 6 1 をメッキ位置（V）まで下降させる（ステップ 2（2））。

この下降操作によりホルダ 6 2 に保持されたウエハ W 下面側の被処理面はメッキバス 4 2 内のメッキ液液面と接触する。

このとき、空気の泡がウエハ W 表面に付着したままでメッキ処理を行なうとウエハ W 表面に形成されるメッキ層が不均一になるので、ウエハ W をメッキ液液面に接触させた状態でドライバ 6 1 のモータ 6 3 を作動させてウエハ W を略水平面

内で回転させることによりウエハW表面の泡抜きを行なう（ステップ2（3））。

泡抜きを十分行なったら同じ高さを維持しながらモータ63の回転速度を下げ、ウエハWとメッキバス42内のアノード44との間に電圧を印加してメッキを開始する（ステップ2（4））。

このメッキ処理時には図7のスイッチSを操作することにより様々なやり方で電圧を印加することができる。例えば、スイッチSのナイフスイッチAとBとを交互に断続させることにより、アノード44からウエハW下面側に向う電流の方向を変化させることができる。

即ち、最初ナイフスイッチAのみを投入してカソードコンタクト64にカソード電圧を印加させると電流はアノード44からウエハWの外周縁に向う流れが強く流れる。しかる後にナイフスイッチAを切って、ナイフスイッチBのみを投入するとカソード電流はセンターカソードコンタクト91を介してウエハWの中心付近に向って流れる。このようにナイフスイッチAと5Bとを交互に断続させることによりアノード44からウエハWに向う電流はウエハWの外周縁に向ったり中心を向ったりを繰り返す。そのため全体としては電流密度はウエハW下面側全体に均一に流れたのと同じことになり、結果として均一なメッキ層が形成される。

所定時間経過して十分な厚さのメッキ層がウエハW上に形成されたら、電圧の印加を停止してメッキ層の形成を停止し、バルブV1を開くと共に汲み出しポンプ51を作動させてメッキ液をタンク50内に戻し、メッキバス42内の液面を下降させ（ステップ2（5））、ホルダ62を上昇させてウエハWをスピンドライ位置（IV）まで移動させる。この状態でモータ63を作動させてウエハWを水平面内で回転させ、スピンドライを実行する（ステップ2（6））。

スピンドライによりメッキ液がウエハWから大方取り除かれたら、ドライバ61を前記した洗浄位置（II）まで上昇させる（ステップ2（7））。

次に、この状態でモータ63を駆動してウエハWを回転させながらノズル70、62から純水をウエハW下面に向けて噴出してウエハW下面を洗浄する（ステップ2（8））。

ウエハW下面の洗浄が終了したら、ドライバ61の高さはそのまま保ち、図示しない昇降機構によりドライバ61内のウエハWだけを僅かに上昇させてノズル70、70から噴出する純水がちょうどウエハW下面と保持部との接点であり、電氣的に接続するカソードコンタクト64に当たる高さまで上昇させる。この状態でノズル70、70から純水を噴出させて前記カソードコンタクト表面を洗浄する（ステップ2（9））。カソードコンタクト64の洗浄が完了したら再びウエハWがこのカソードコンタクト64と当接する高さまで下降させ（ステップ2（10））、モータ63を作動させてスピンドライを行なって水分を取り除く（ステップ2（11））。

スピンドライが完了したら、ドライバ61を搬送位置（I）まで上昇させ（ステップ2（12））、この位置で維持しながらゲートバルブ73を開いてメインアーム35を進入させ、メッキ処理ユニットM1での処理が完了したウエハWを搬出する（ステップ2（13））。

メッキ処理ユニットM1でのメッキ処理工程が完了したら、後続の処理を行なう処理ユニットへウエハWを搬送する。例えば前記メッキ処理ユニットM1とは組成の異なるメッキ液を用いる他のメッキ処理ユニットM2～M4で更に別のメッキ処理を行なう場合には当該メッキ処理ユニットM2～M4内へ搬入して前記と同様にして追加の後続のメッキ処理を行なう。

メッキ処理ユニットM1から後続の他の処理ユニット、例えばメッキ処理ユニットM2～M4や、第2の処理装置としての洗浄処理ユニット等へ搬送する間に、必要に応じてウエハWをメインアーム35で保持したまま上下反転させる。例えばメッキ処理ユニットM1でウエハWの下面側にメッキ層を形成した後、洗浄処理ユニットでメッキ層を形成した面を上側にして洗浄する場合等である。このようにウエハWの搬送時にメインアーム35上でウエハWを上下反転できるので、処理の工程に無駄がなく、速やかにウエハWの搬送と上下反転とを同時に行なうことができる。

一連のメッキ処理工程が完了したら、最後のメッキ処理ユニットM1～M4内へメインアーム35がアクセスしてメッキ処理の完了したウエハWを取り出す。

しかる後にメインアーム35はウエハWを保持したままその保持部35aを処

理空間 S の上部へ移動させ、メッキ処理ユニット M 1 ～ M 4 の上段側に配設されている洗浄処理ユニット 1 7 0 内に搬入する。

このとき、処理空間 S 内には図中上方から下方に向けてクリーンエアが流下するダウフローが形成されているので、下段側のメッキ処理ユニット M 1 ～ M 4 の方から上段側の洗浄処理ユニット 1 7 0 側へ空気が流れることはない。そのため、処理空間 S 内の洗浄処理ユニット 1 7 0 近傍の雰囲気は常にメッキ処理ユニット M 1 ～ M 4 近傍の雰囲気より清浄に保たれる。

洗浄処理ユニット 1 7 0 による洗浄処理が完了したら、後続の処理、例えば第 3 の処理としてのアニーリング処理を行なう。このアニーリング処理はいわゆる熱盤上にウエハ W を所定時間載置することにより行う。

アニーリングが完了したら、再びメインアーム 3 5 が処理後のウエハ W を受け取り、中継載置部 3 6 を経由して、或いは洗浄処理ユニット 1 7 0 内を経由してメインアーム 3 5 からサブアーム 2 2 へ引き渡される。

サブアーム 2 2 に引き渡された処理後のウエハ W は前記と逆の径路を通してキャリアカセット C 内に収容され、一連の処理が完了する。

以上説明したように、本実施形態に係るメッキ処理ユニットでは、カソードコンタクト 6 4 の他に、カソード電圧をウエハ W の裏面に印加するためのセンターカソード 9 0 を備えているので、前記カソードコンタクト 6 4 と組み合わせて使用することにより、アノード 4 4 からウエハ W に流れる電流の方向を制御することが出来る。この電流の流れを制御することにより、全体としてアノード 4 4 からウエハ W 下面全体にわたって均一に電流を流すことができるので、銅イオンの流れをもそれに伴ってウエハ W 下面全体に行き渡らせることが出来る。その結果としてウエハ W 下面全体にわたって均一な厚さのメッキ層を形成することができる。

なお、本発明は上記実施形態に限定されない。例えば上記実施形態ではシリコンウエハを例にして説明したが、LCD 用ガラス基板についても適用できることは言うまでもない。

（第 2 の実施の形態）

以下、本発明の第 2 の実施形態について説明する。以下の実施の形態について

、先行する実施の形態と重複する内容については説明を省略することがある。

図 1 0 は本発明の第 2 の実施形態に係るセンターカソード 9 0 の垂直断面図である。

図 1 0 に示したように、本実施の形態に係るセンターカソード 9 0 では、ウエハ W の下面側のシード層 C に直接センターカソードコンタクト 9 1 が接触する構成とした。

即ち、このセンターカソード 9 0 では可撓性導電性材料で形成され、断面がアルファベットの「T」字型のセンターカソードコンタクト 9 1 を上下さかさまにした状態で保持し、途中にお椀型のシーラント 9 4 を貫通した形状を備えている。

このセンターカソード 9 0 を用いる場合には、ウエハ W の被処理面側にシード層 C が形成されたウエハ W を用意し、このウエハ W の中心に貫通孔 h を穿孔したものをを用いる。

図 1 0 の小円 A に示したように、ウエハ W の裏面側から貫通孔 h にセンターカソードコンタクト 9 1 の頭の部分を押し当てる。センターカソードコンタクト 9 1 は導電性可撓性材料からできているので、貫通孔 h を通過する際に頭の部分は折り曲げられて半径方向の寸法が縮む。

更に押し込んでゆくと小円 B に示したように、頭の部分が貫通孔 h を通過し、再び頭の部分が膨らんで端の部分がウエハ W 下面側のシード層 C と接触する。一方、ウエハ W の裏面側ではお椀型のシーラント 9 4 が撓んでその下端部がウエハ W 裏面側の表面に押圧され、ウエハ W との接触部分でシールする。

本実施形態に係るセンターカソード 9 0 では、ウエハ W の被処理面側でセンターカソードコンタクト 9 1 が接触するので、ウエハ W の中心に貫通孔 h を穿孔するのみでよく、裏面側にまでシード層 C を形成する必要がないという特有の効果を得られる。

(第 3 の実施の形態)

本実施形態に係るメッキ処理ユニットでは、ウエハ W の被処理面の中心にセンターカソード 9 0 をウエハ W の被処理面側から接触させる構造を採用した。

図 1 1 は本実施形態に係るメッキ処理装置の概略構成図であり、図 1 2 は本実

施形態に係るセンターカソード 9 0 の垂直断面図であり、図 1 3 は本実施形態に係るホルダ 6 2 の垂直断面図であり、図 1 4 は本実施形態に係るホルダ 6 2 の斜視図である。

図 1 1 に示したように、本実施形態に係るメッキ処理ユニットでは、ウエハ W 下面側の被処理面側からセンターカソード 9 0 を接触させる構造を採用している。

図 1 2 に示したように、本実施形態に係るセンターカソード 9 0 では、シリコンラバーなどの比較的柔らかい絶縁性樹脂でできたカップ状のシーラントを兼ねるハウジング 9 0 の中に金属などの導電性材料でできたセンターカソードコンタクト 9 1 が、付勢のための弾性材例えばスプリング 9 2 を介して出沒可能に收容されており、センターカソードコンタクト 9 1 には電源と接続するためのリード線（図示省略）が接続されている。

このハウジングの側壁部分は中空構造になっており、外部からガス供給路 9 3 a を介してハウジング内の空間 9 3 b に供給された窒素ガスは、ハウジング側壁開口側端部に設けられたシール部 9 3 c を経て側壁内の空間 9 3 d へ流れ込み、最終的にはガス排出路 9 3 e を経てセンターカソードコンタクト 9 0 の外へ排出されるようになっている。この窒素ガスなどの気体により、ハウジング内の空間 9 3 b は陽圧に維持されており、メッキ液が内部に侵入しないようになっている。

このセンターカソードコンタクト 9 0 を用いる例として図 1 3 に示したようなホルダ 6 2 を用いる方法が挙げられる。図 1 3 に示した状態を斜視図として示したのが図 1 4 である。

図 1 4 に示したように、本実施形態のセンターカソード 9 0 はウエハ W の下面側から上向きにウエハ W 下面側に接触するようになっており、このセンターカソード 9 0 は円形及び星型のフレーム 6 2 a によりホルダ 6 2 に固定されている。

本実施形態に係るメッキ処理ユニットでは、ウエハ W の下面側からウエハ W の中心に接触するセンターカソード 9 0 を採用しているので、ウエハ W に貫通孔 h を穿孔する必要がなく、ウエハ W から製造される半導体素子の歩留まりを向上させることができる。

更に、本実施の形態では、センターカソード90を支持する円形及び星型のフレーム62aがホルダ62と共に回転するので、このフレーム62aがメッキ液の攪拌羽根として機能するため、メッキ液が均一になりやすく、メッキ層の均一化に寄与する。

(第4の実施の形態)

図15は本実施形態に係るメッキ処理ユニットにおけるカソードとウエハWとの接点とを図示した概略構成図である。

本実施形態では、ウエハWの被処理面を複数の領域、例えば4つの領域A1～A4に分割し、A1～A4の各領域ごとにゾーンカソードコンタクトZ1～Z4を一つずつ設けて下面側から接触させている。

本実施形態に係るメッキ処理ユニットでは、ウエハW外周縁で接触するカソードコンタクト64, 64, …及び前記ゾーンカソードコンタクトZ1～Z4との間でカソード電圧を印加するタイミングをずらしながらメッキ処理を行なう。

例えばカソードコンタクト64とゾーンカソードコンタクトZ1～Z4のうちの一つとを交互に切り換え、64→A1→64→A2→64→A3→64→A4→64→A1→…のように順次切り換える方式が挙げられる。

本実施形態によれば、ウエハW面内をいくつかの領域(ゾーン)に分割し、各領域と外周縁との間で印加電圧を交互に切り換えながらメッキ処理を行なうので、全体として電流分布が均一化され、その結果ウエハW全体にわたって均一な厚さのメッキ層が得られる。

(第5の実施の形態)

本実施形態のメッキ処理ユニットでは、センターカソードコンタクト91が微小な複数の接点(コンタクト)を束ねた構造を採用した。

図16は本実施形態に係るセンターカソード90の垂直断面図である。

本実施形態に係るセンターカソード90では、複数個の微小な接点(コンタクト)をゴムなどの可撓性材料で束ね、この微小な接点の集合体を一つのセンターカソードコンタクト91として用いる。

本実施形態に係るセンターカソード90では、ウエハWに対する接触面積が大きくなるので、より確実にカソード電圧を印加できるという利点を得られる。

【発明の効果】

本発明によれば、ウエハWの面内で厚さが均一なメッキ層を形成することのできるメッキ処理装置やメッキ処理方法が提供される。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

第 1 の実施形態に係るメッキ処理システムの斜視図である。

【図 2】

第 1 の実施形態に係るメッキ処理システムの平面図である。

【図 3】

第 1 の実施形態に係るメッキ処理システムの正面図である。

【図 4】

第 1 の実施形態に係るメッキ処理システムの側面図である。

【図 5】

第 1 の実施形態に係るメッキ処理ユニットの垂直断面図である。

【図 6】

第 1 の実施形態に係るメッキ処理ユニットのホルダ周辺部の垂直断面図である。

【図 7】

本実施形態に係るメッキ処理ユニットのカソード電圧印加系統を示す配線図である。

【図 8】

第 1 の実施形態に係るメッキ処理システム運転時のフローチャートである。

【図 9】

第 1 の実施形態に係るメッキ処理ユニットのメッキ処理のフローチャートである。

【図 1 0】

本発明の第 2 の実施形態に係るセンターカソード 9 0 の垂直断面図である。

【図 1 1】

本発明の第 3 の実施形態に係るメッキ処理ユニットの概略構成図である。

【図 1 2】

本発明の第 3 の実施形態に係るセンターカソードの垂直断面図である。

【図 1 3】

本発明の第 3 の実施形態に係るホルダの垂直断面図である。

【図 1 4】

本発明の第 3 の実施形態に係るホルダの斜視図である。

【図 1 5】

本発明の第 4 の実施形態に係るカソードとウエハ W との接点とを図示した概略構成図である。

【図 1 6】

本発明の第 5 の実施形態に係るセンターカソードの垂直断面図である。

【図 1 7】

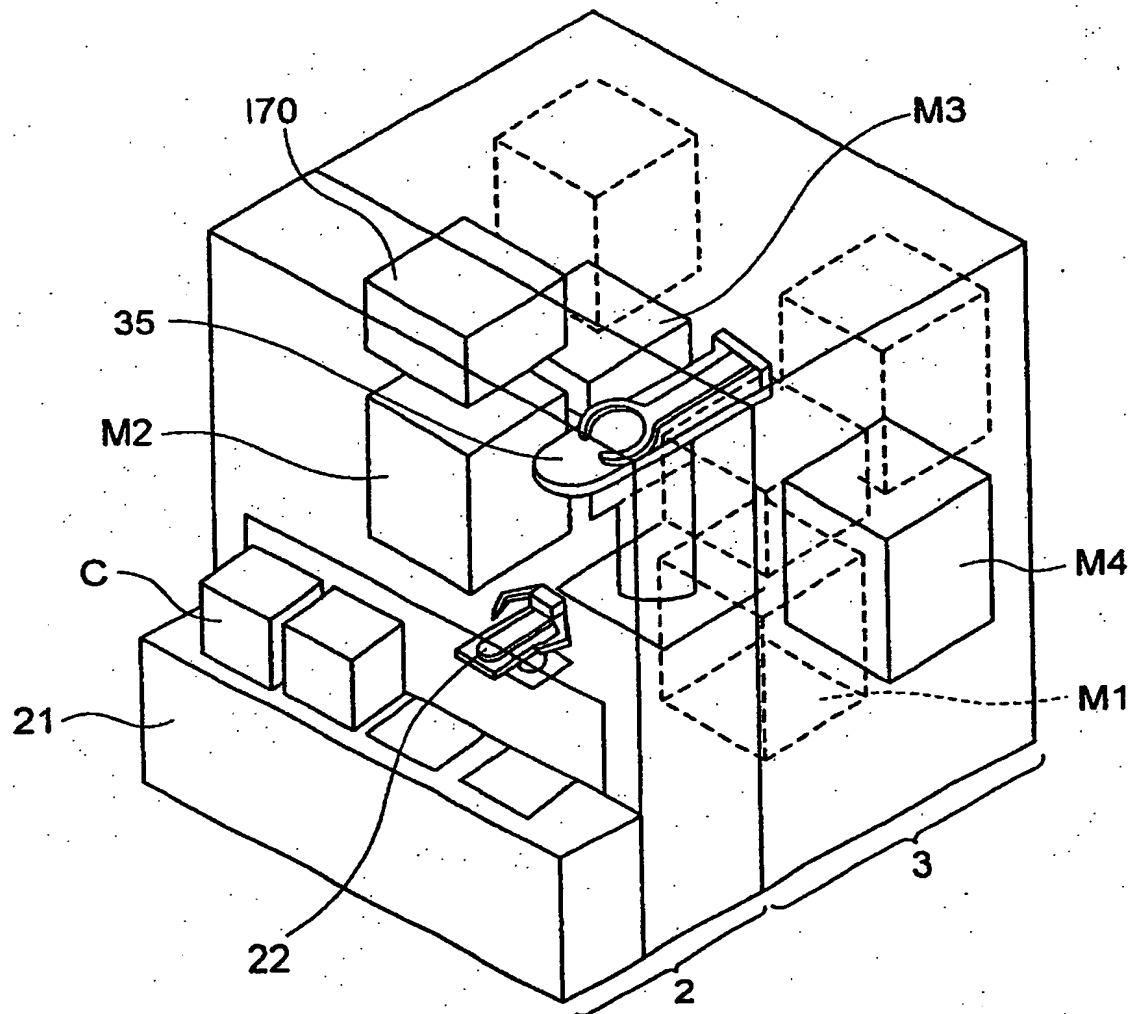
従来のフェイスダウン方式のメッキ処理装置の垂直断面図である。

【符号の説明】

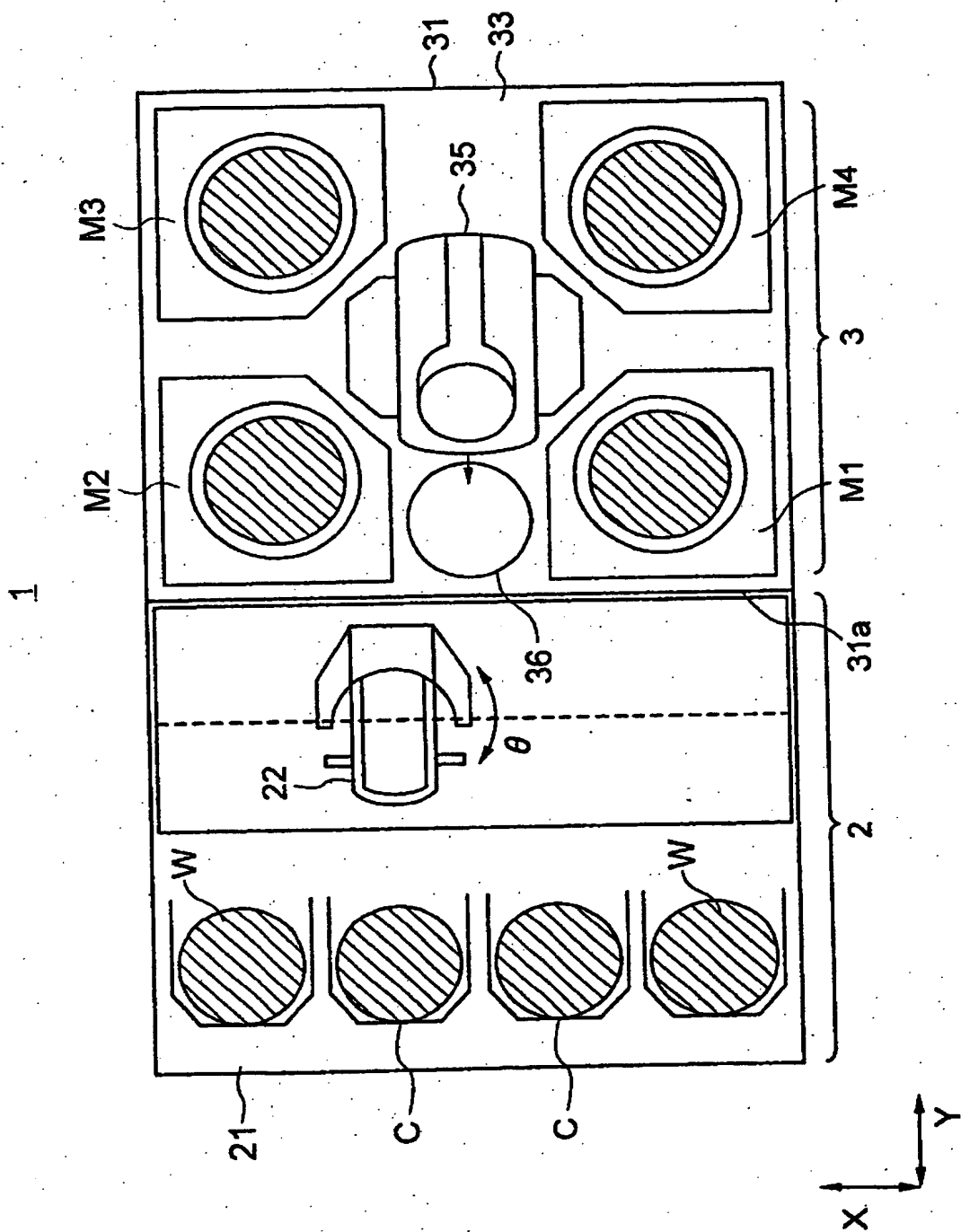
- W…ウエハ（被処理基板）、
- 4 2…メッキバス（処理液槽）、
- 6 2…ホルダ、
- 6 4…カソードコンタクト（第 2 の電圧印加手段）、
- 4 4…アノード、
- h…貫通孔、
- 9 0…センターカソード（第 1 の電圧印加手段）、
- 9 1…センターカソードコンタクト（第 1 の電圧印加手段）、

【書類名】 図面

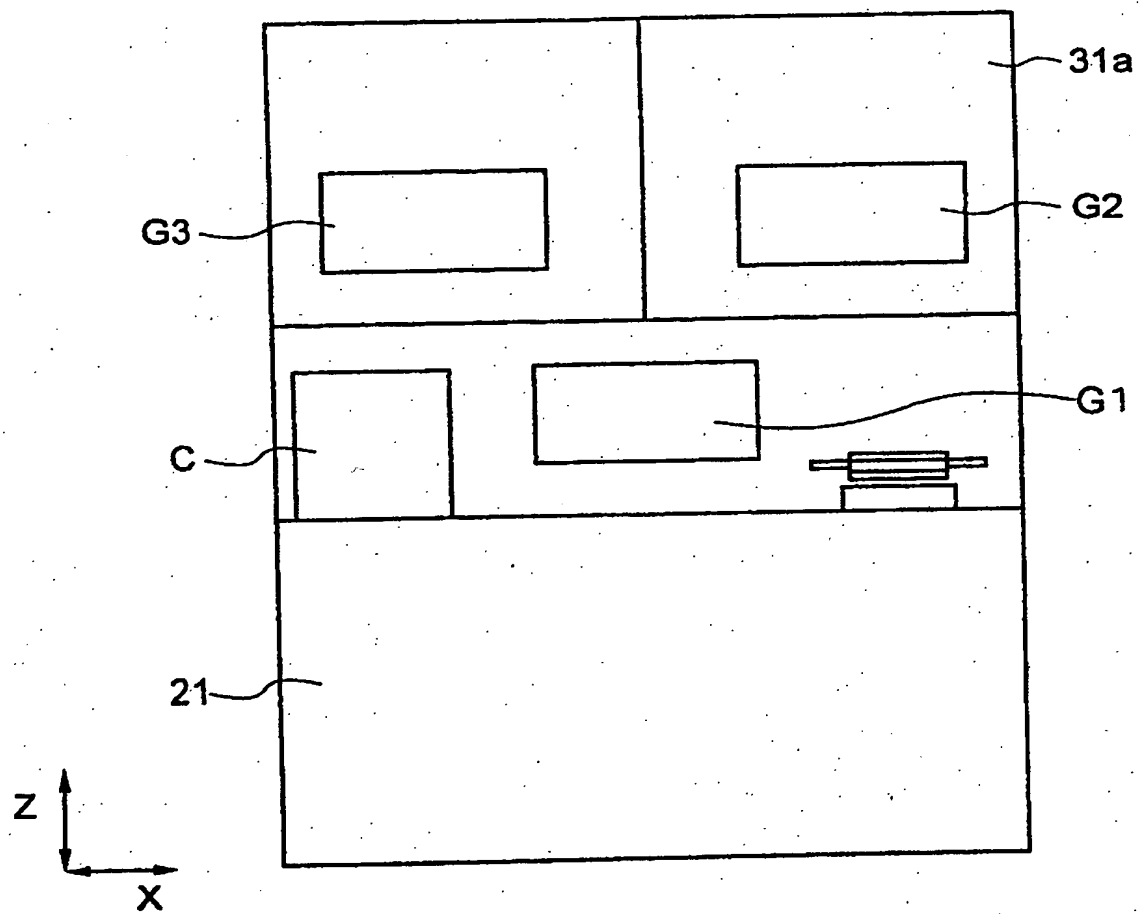
【図 1】



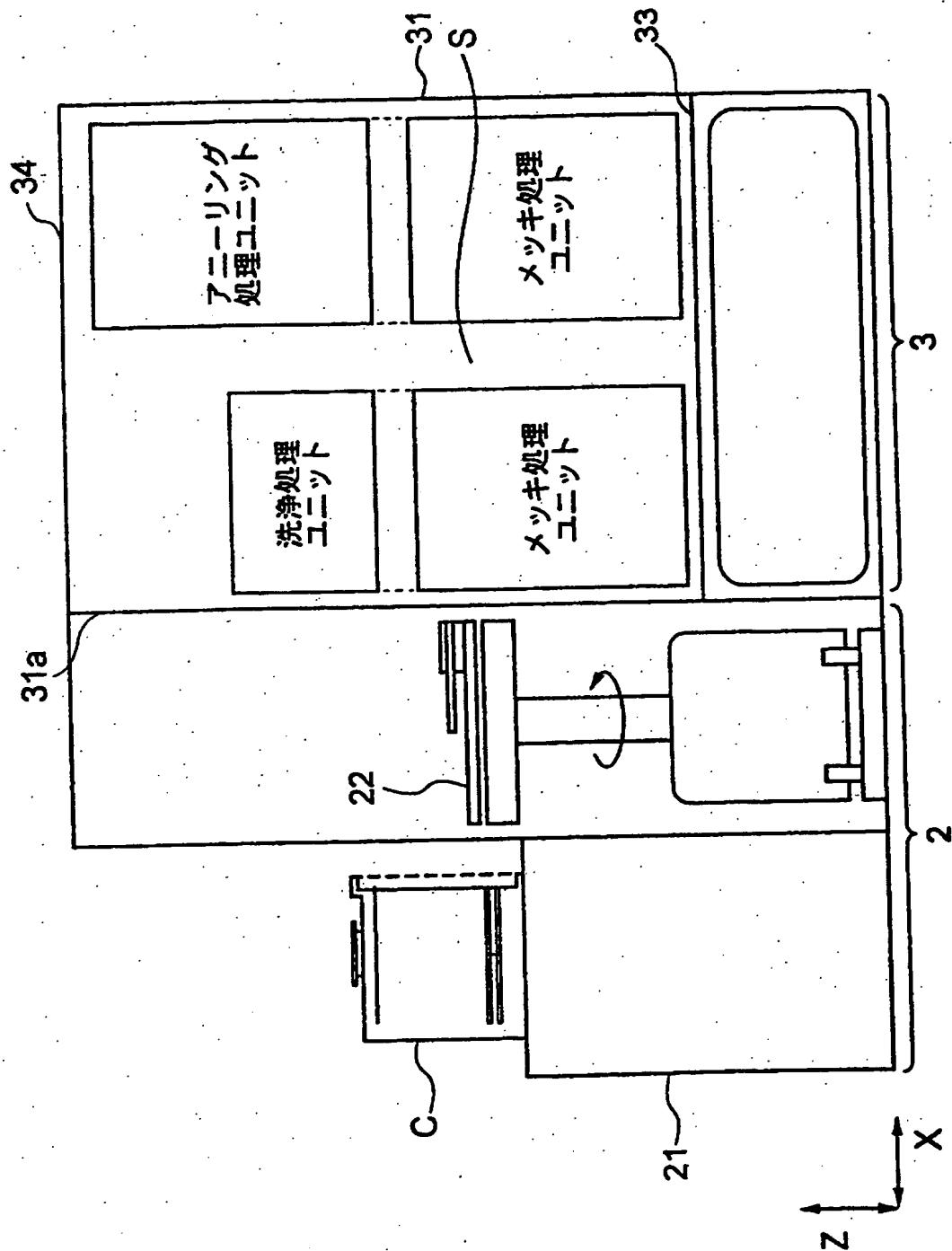
【図 2】



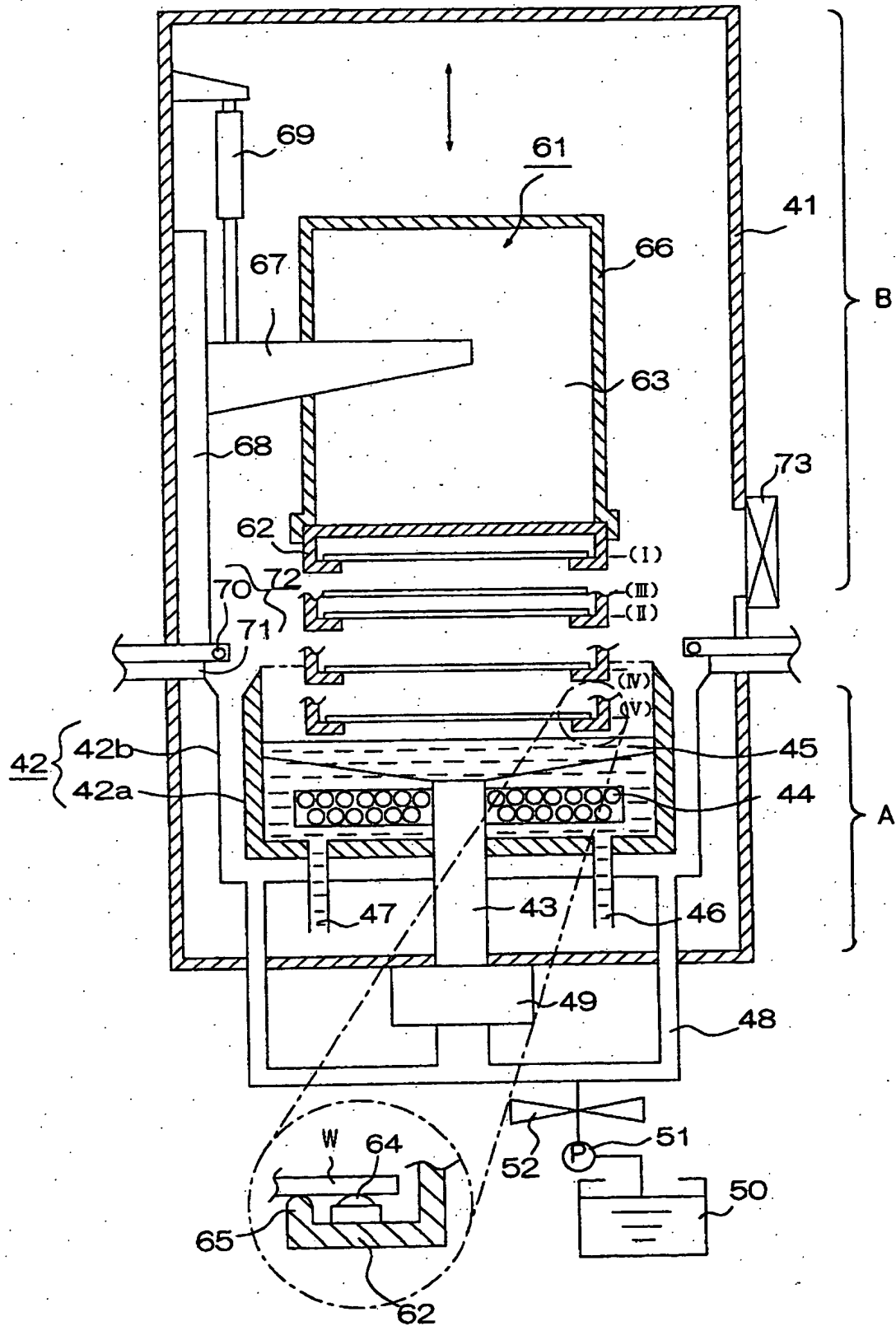
【図 3】



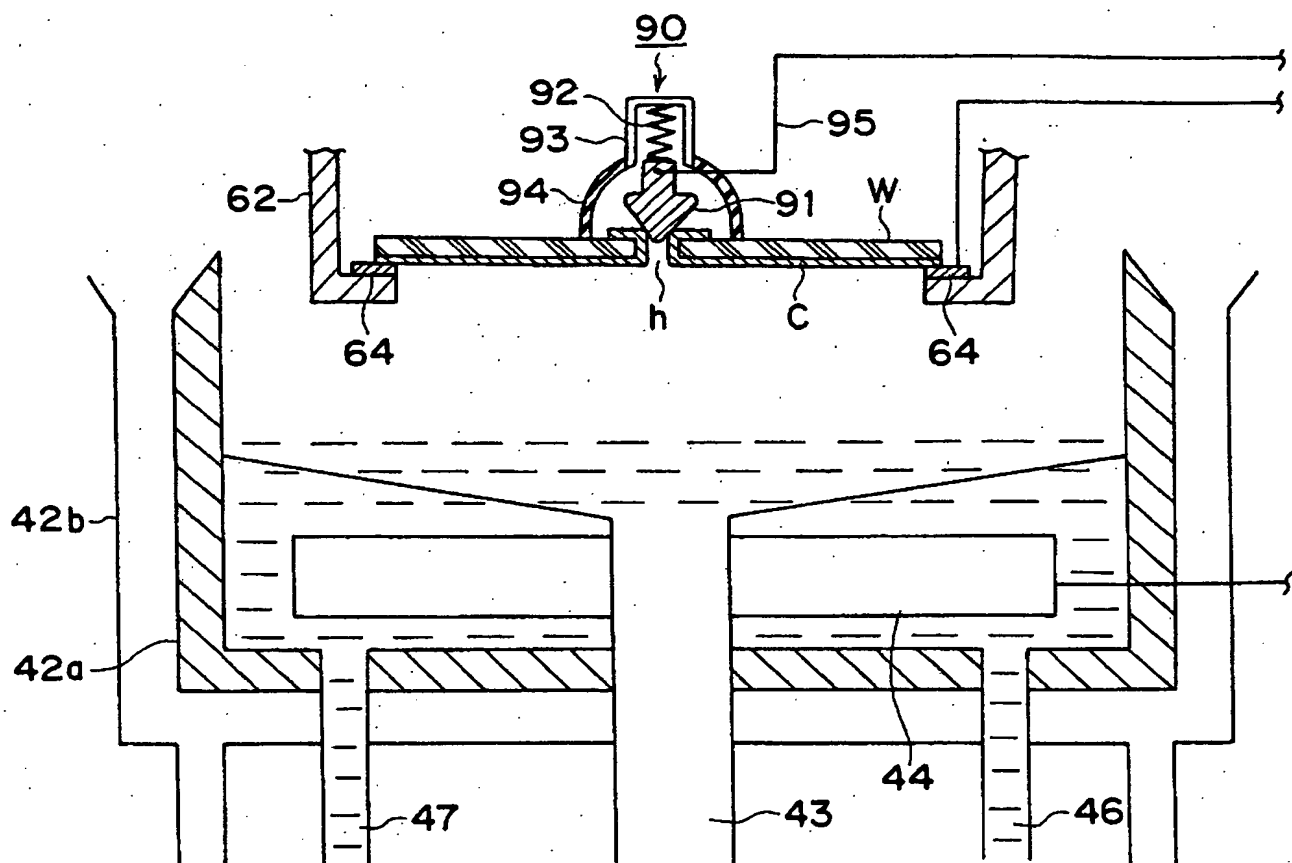
【図 4】



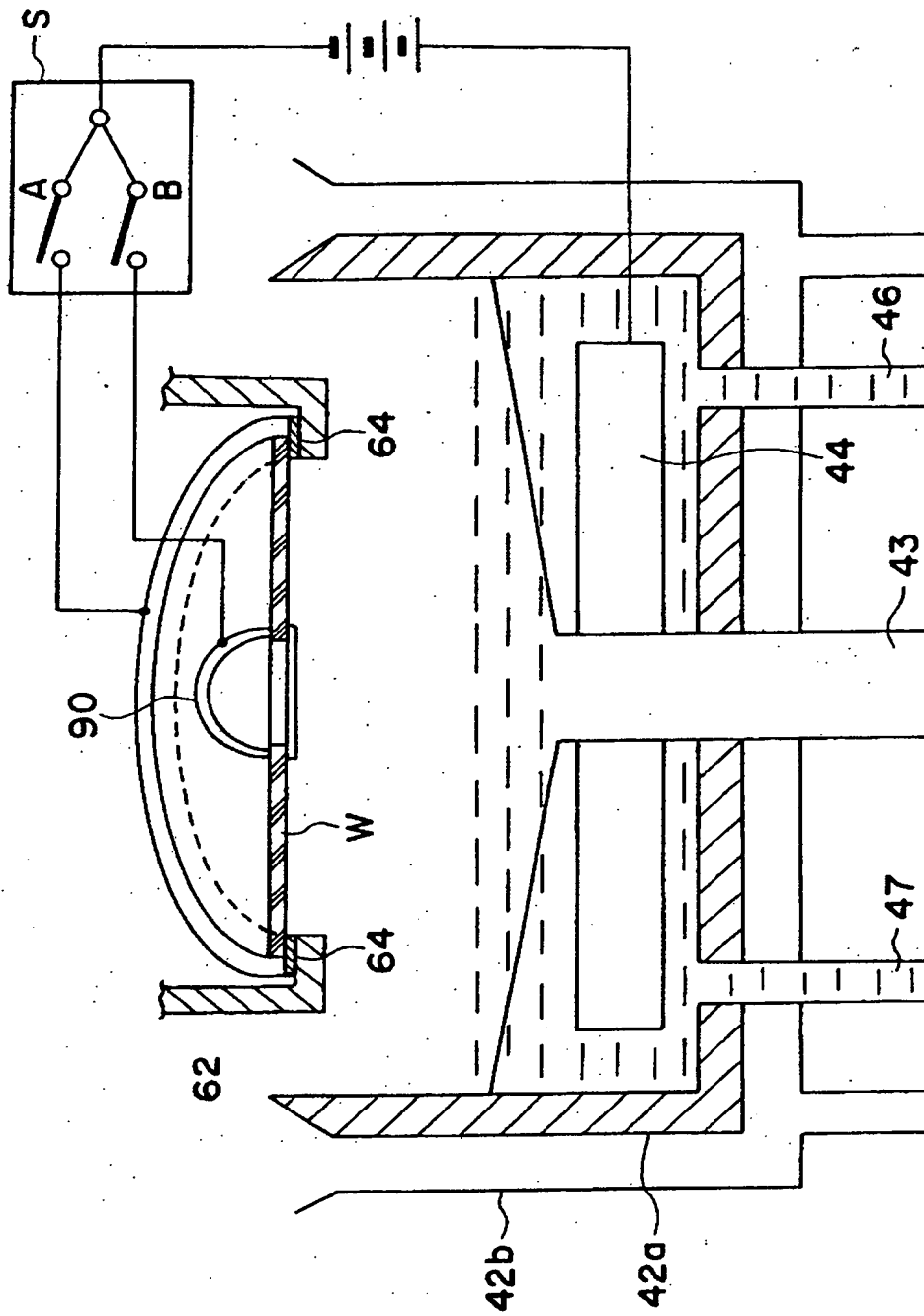
【図 5】



【図 6】

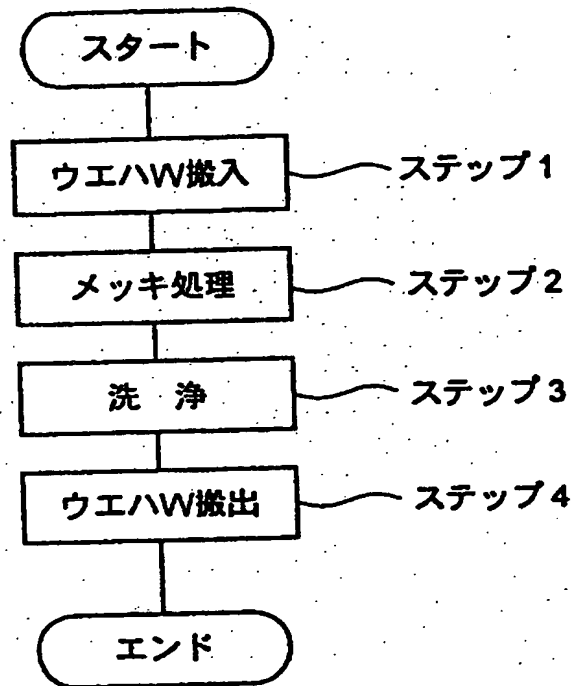


【图 7】



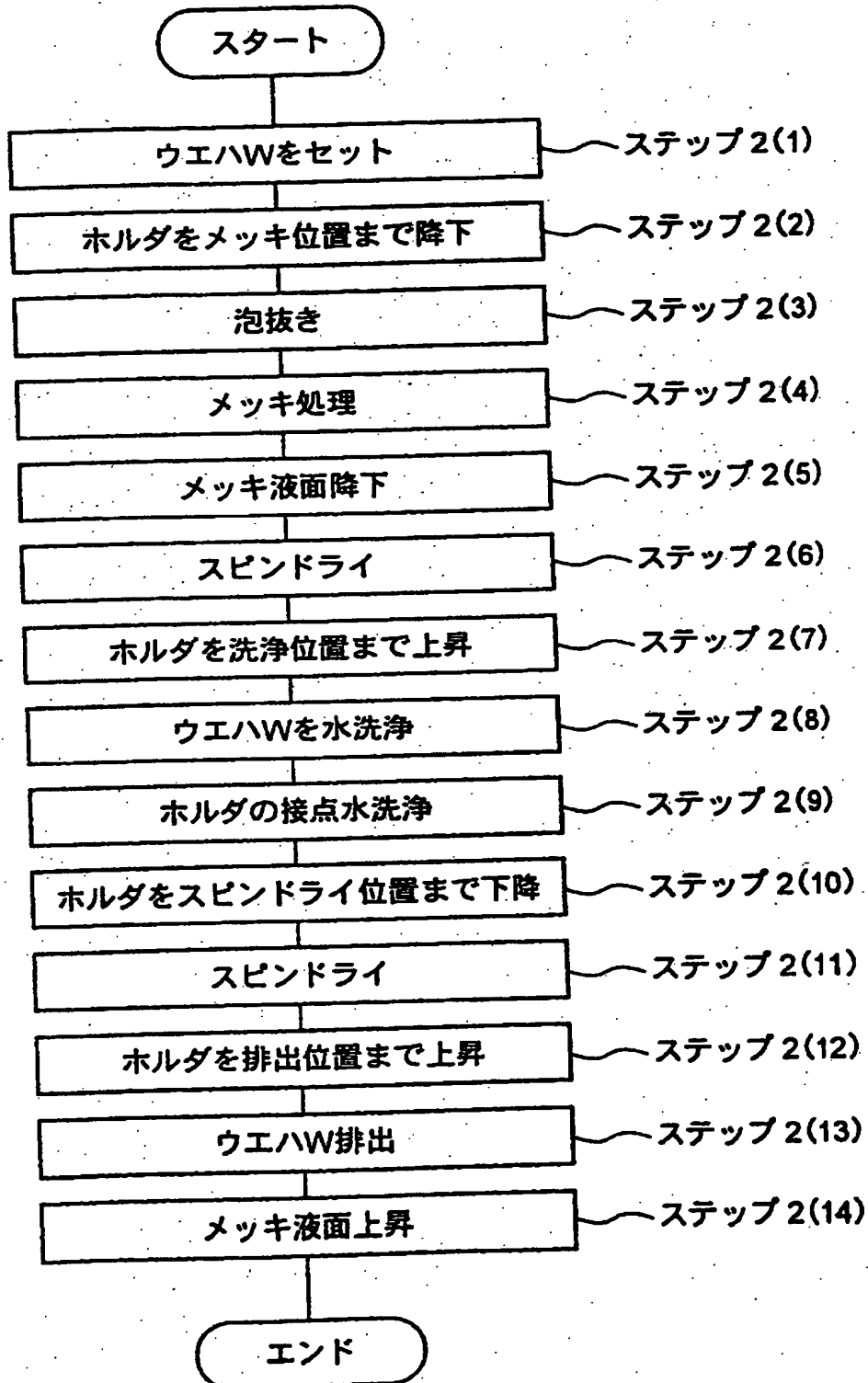
【図 8】

システム全体のフロー

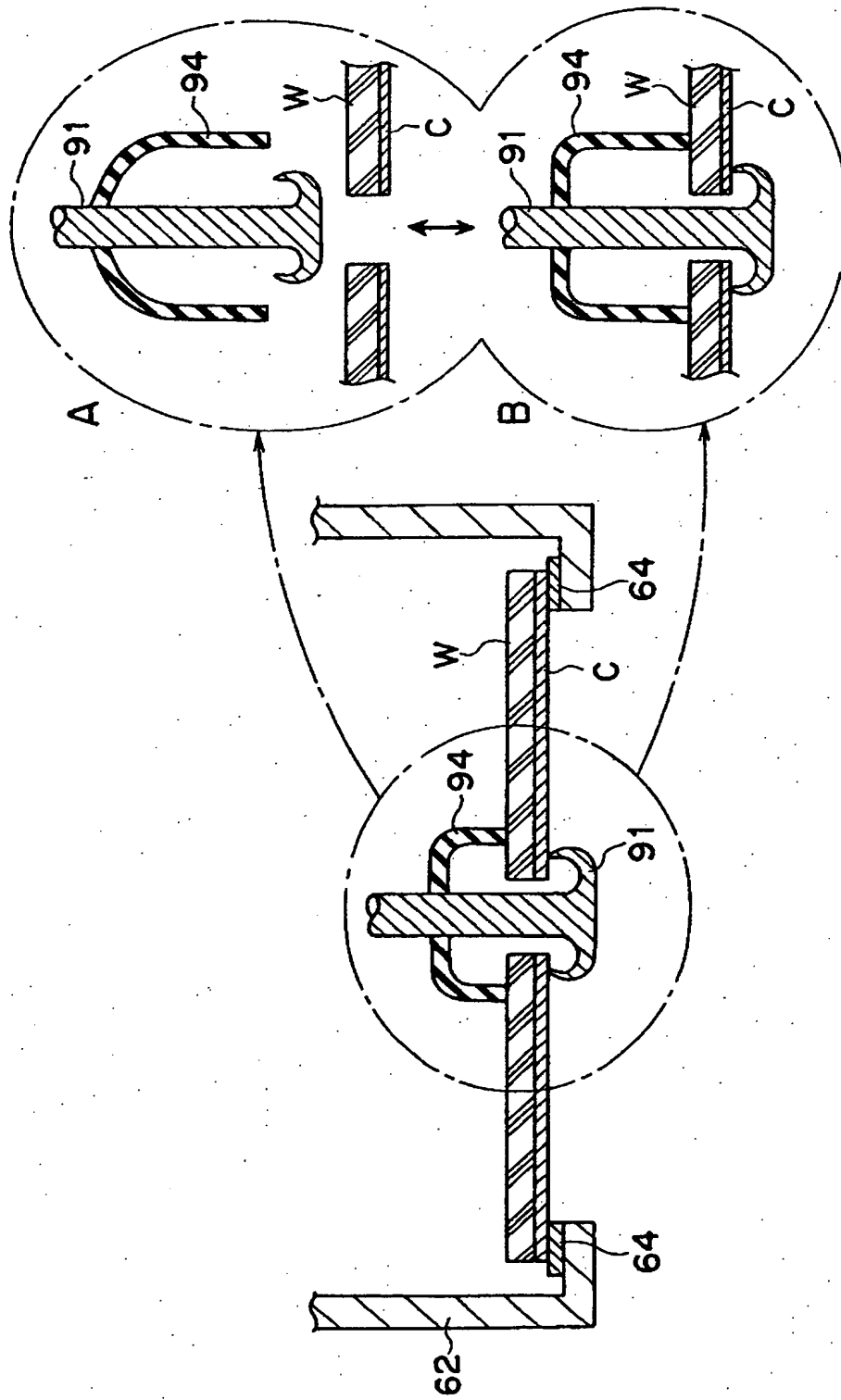


【図9】

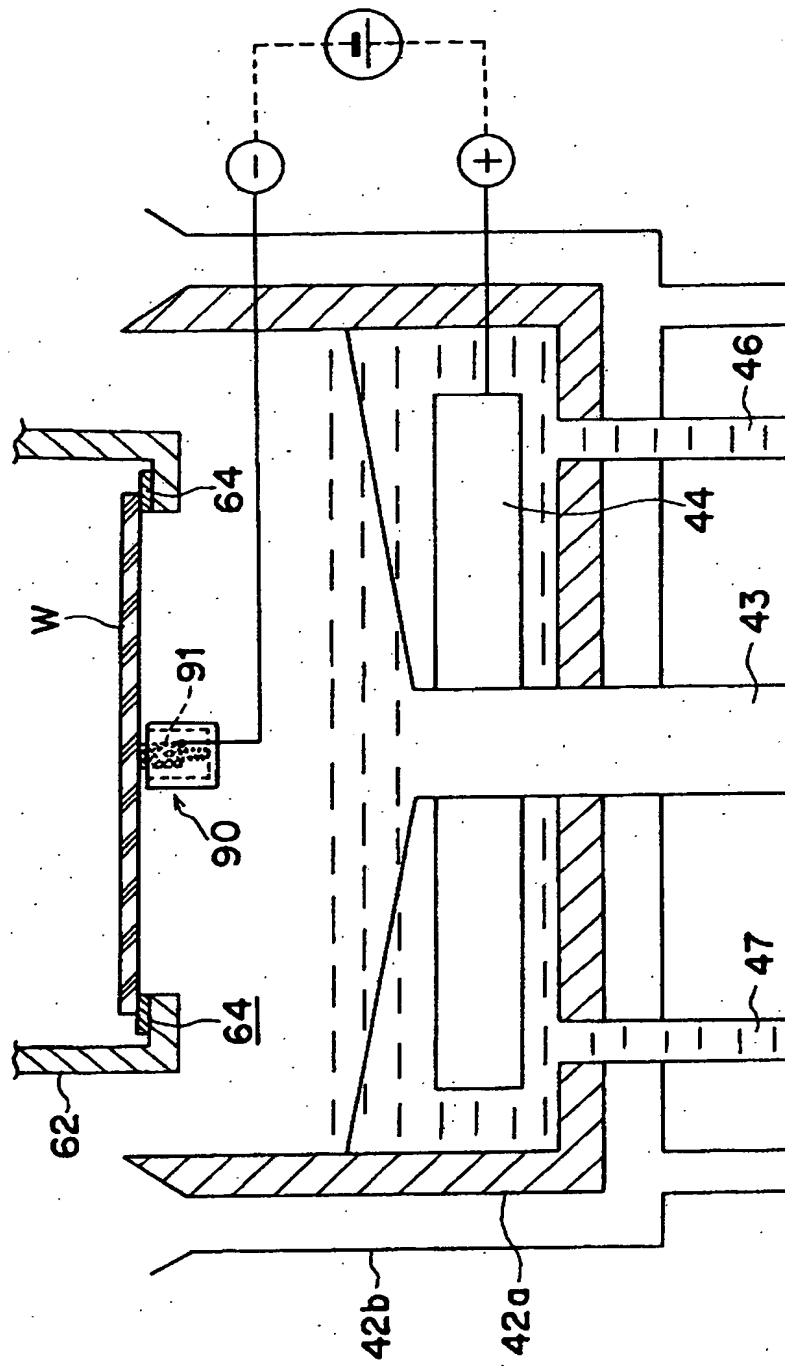
メッキ処理のフロー



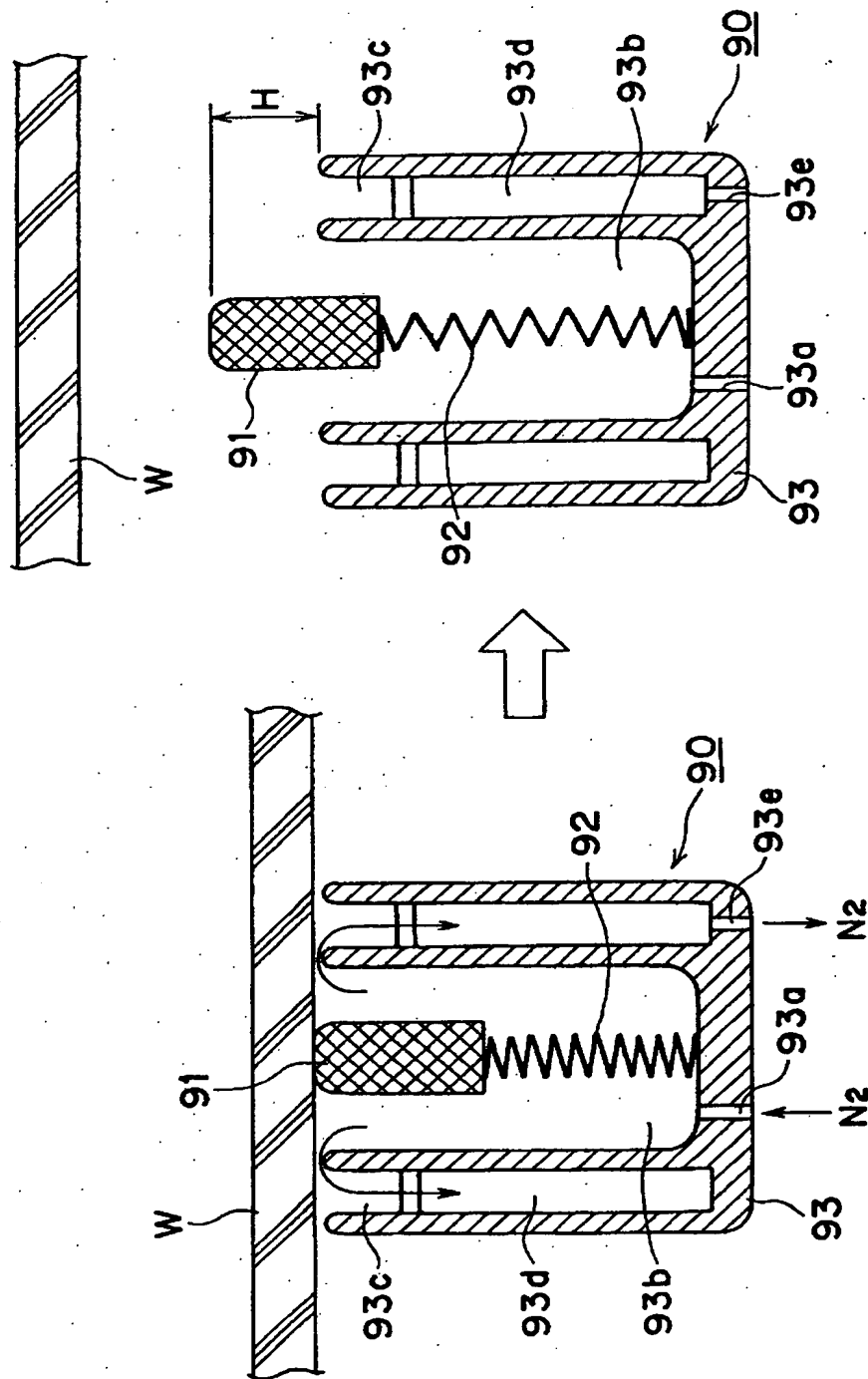
【図10】



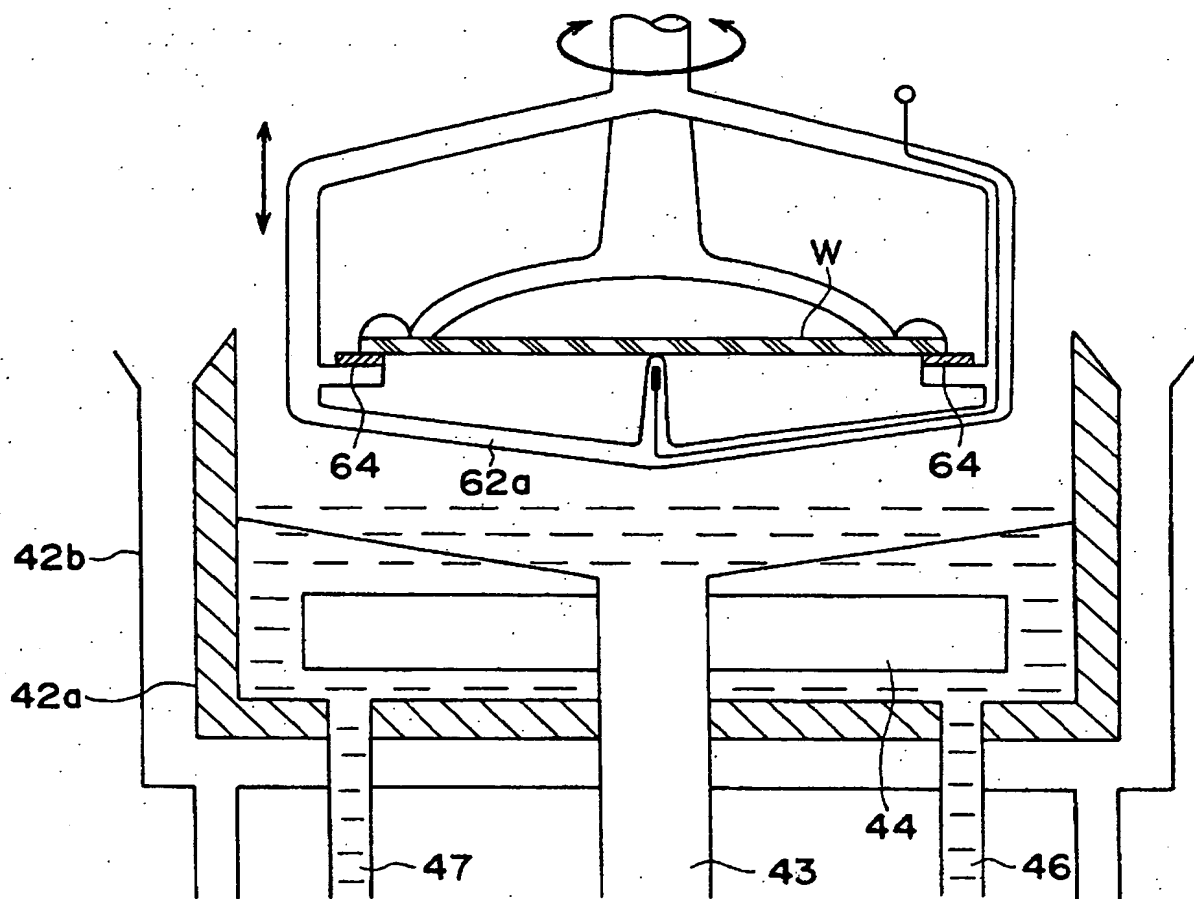
【図 11】



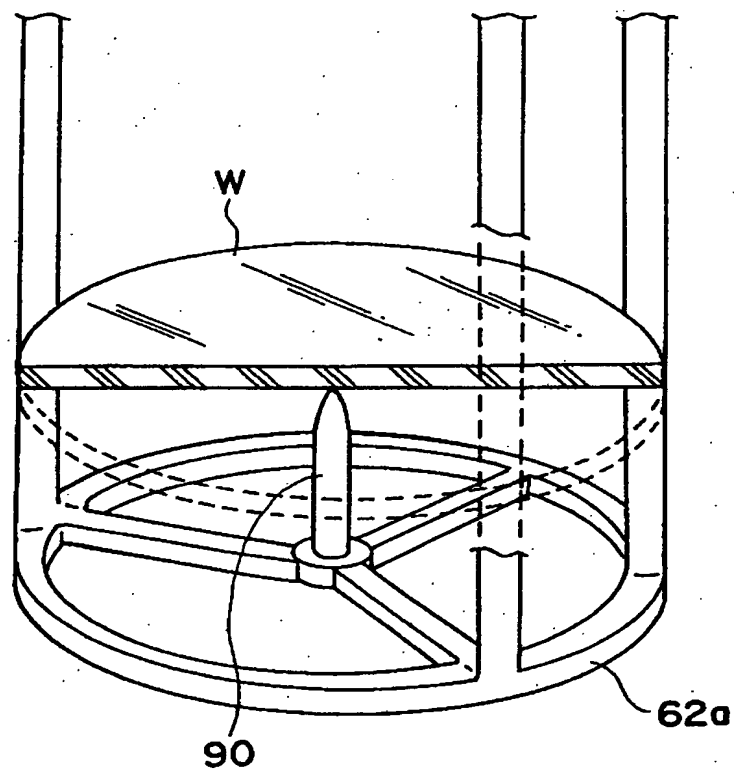
【図 12】



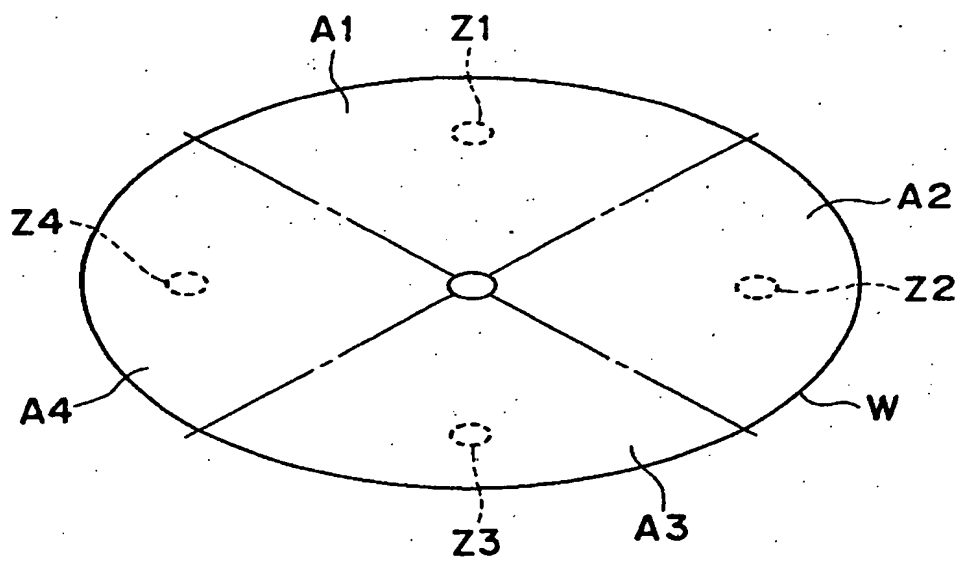
【図13】



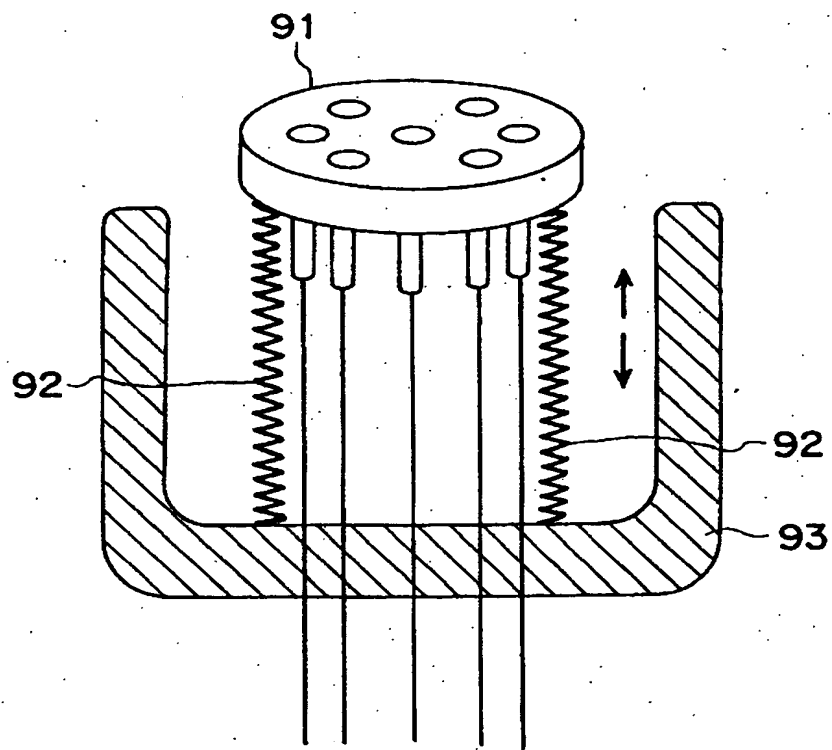
【図 14】



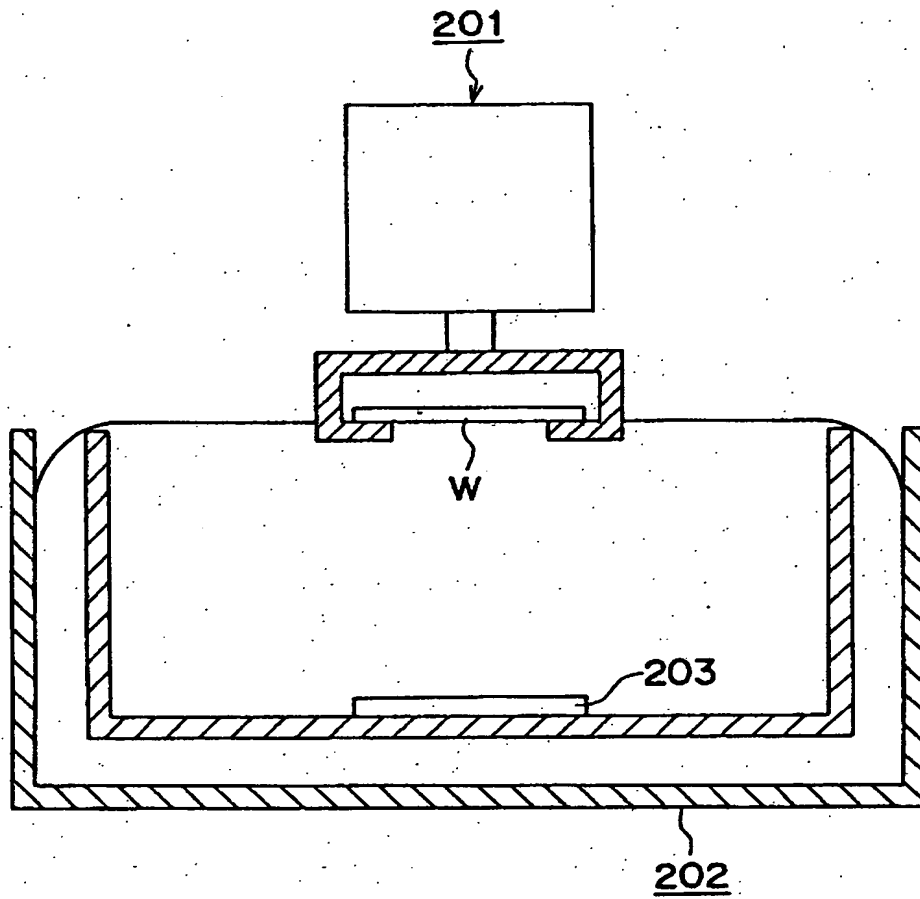
【図 15】



【図 1 6】



【図 17】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ウエハの面内で厚さが均一なメッキ層を形成することのできるメッキ処理装置及びメッキ処理方法を提供する。

【解決手段】 ウエハWにカソード電圧を印加する接点として、ウエハW外周縁側に配設されたカソードコンタクト64, 64, …の他に、ウエハWの中心で接触するセンターカソード90を配設し、前記カソードコンタクト64, 64, …とこのセンターカソード90との間で交互にカソード電圧を印加する。メッキバス42底部に配設された一つのアノード44に対してカソード電圧が高くなる部分が外周縁側のカソードコンタクト64, 64, …付近になったり、ウエハWの中心部になったりするので、電流の方向が散乱され、全体としてウエハW下面側の電流密度が均一化され、その結果ウエハW全体にわたって均一な厚さのメッキ層が形成される。

【選択図】 図7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000219967]

1. 変更年月日	1994年 9月 5日
[変更理由]	住所変更
住 所	東京都港区赤坂5丁目3番6号
氏 名	東京エレクトロン株式会社